

송윤흡

송윤흡은 서울캠퍼스 [공과대학 융합전자공학부](#) 교수이자, [지능형 반도체 시스템 연구실](#)장을 겸임하고 있다.

융합전자공학부 홈페이지 참고(2019.10.)

- 연락처: 02-2220-4135 / yhsong2008@hanyang.ac.kr

□

목차

- [1 학력](#)
- [2 경력](#)
- [3 연구관심분야](#)
- [4 연구](#)
 - [4.1 3차원 플래시 메모리 소자의 다치화 가능한 강유전체 신소재 개발\(2020.06\)](#)
 - [4.2 혁신적인 반도체 소재 및 소자·공정 기술, 2019년 삼성미래기술육성사업 지정 테마 연구지원 과제 선정](#)
- [5 주요논문](#)
- [6 저서](#)
- [7 수상](#)
- [8 언론 활동](#)

학력

- Tohoku Univ. 반도체공학과 공학박사

경력

- 2011 ~ 현재 한양대학교 공과대학 연구부학장
- 2010 ~ 현재 한양대-삼성전자 산학협동연구운영위원
- 2008 ~ 현재 한양대-하이닉스 산학협동연구운영위원
- 2008 ~ 현재 한양대 나노반도체공학부 부교수
- 2008 ~ 현재 한양대 융합전자공학부 부교수
- 1983 ~ 2008 삼성전자 반도체사업부 상무이사=연구관심분야=

연구관심분야

바이오 IT 소자 및 시스템, 차세대 메모리 소자, 선택 소자 및 설계 기술, 차세대 Logic 소자

연구

3차원 플래시 메모리 소자의 다치화 가능한 강유전체 신소재 개발(2020.06)

- 송윤흡 융합전자공학부 교수 공동연구팀이 3차원 플래시 메모리 소자의 고단화 및 저전력 문제를 해결할 수 있는 강유전체 신소재를 개발했다.
- 이번 연구는 기존 3D 플래시 메모리 소자들을 지속적으로 고단화하는 과정에서 해결해야 할 과제였던 ‘두께 줄이기’를 현실화할 수 있는 가능성을 내보였다는 점에서 높이 평가받는다.
- 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터사업의 지원을 받아 한양대 [최창환 신소재공학부](#) 교수팀과 공동으로 진행됐다.
- 반도체 관련 세계적으로 권위 있는 학회인 전기전자기술자협회(IEEE)의 초고밀도 집적회로(VLSI) 관련 심포지엄에 소개됐으며, 특히 기술위원회가 선정한 13개 ‘하이라이트’ 논문으로 채택돼 학회 미디어프레스에 소개되어 주목을 받았다.

혁신적인 반도체 소재 및 소자·공정 기술, 2019년 삼성미래기술육성사업 지정 테마 연구지원 과제로 선정

낸드플래시 메모리를 100층 이상 집적하기 위한 신규 소재

주요논문

저서

수상

언론 활동